**PARA DIFUSIÓN INMEDIATA**

**[SAMTEC LOGO] Julio 2021**

**Samtec anuncia la familia de matrices de alto rendimiento AcceleRate® HP**

*La base para nuevas soluciones de interconexión PICMG COM-HPC®*

**New Albany (Indiana, EE.UU.):** Samtec Inc., un fabricante de una amplia gama de soluciones interconexión electrónica con presencia global y una facturación de 800 millones de dólares, anuncia la nueva generación de matrices de alto rendimiento AcceleRate HP, que alcanza PAM a 112 Gbps en un formato extremadamente pequeño.

Las matrices de alto rendimiento AcceleRate HP integran una matriz con la base de conexiones abierta para optimizar la flexibilidad de conexión a tierra y enrutamiento. Los arquitectos de sistemas pueden enrutar pares diferenciales, señales de terminación sencilla y carriles de tensión de alta corriente a través de la misma interconexión.

Además, el paso de fila de 2,2 / 2,4 / 2,2 mm facilita el enrutamiento de señales diferenciales. La diafonía se ve mejorada con el mayor espacio y la capacidad de añadir más conexiones a tierra alrededor de señales diferenciales.

“Las nuevas matrices de alto rendimiento AcceleRate HP de Samtec son la referencia de PAM a 112 Gbps en un formato pequeño”, declaró Michael Boone, Product Manager de Conexiones de Alta Velocidad entre Placas de Samtec, Inc. “Las aplicaciones de rápido crecimiento, como aceleradores de IA, emuladores de ASIC y plataformas informáticas en la periferia (edge) de próxima generación, aprovechan estas ventajas exclusivas”.

Estas son algunas de las principales características de las matrices de alto rendimiento AcceleRate HP:

* Paso denso de 0,635 mm
* Bajo perfil de 5 mm y alturas de apilamiento de hasta 10 mm
* Hasta 400 patillas disponibles en total
* Previsión de hasta 1000 patillas
* Velocidad de transmisión de datos compatible con PCIe® 5.0 y 100 GbE
* Terminación BGA para facilitar el montaje y autoalineamiento

Para más información sobre las matrices de alto rendimiento AcceleRate HP, visite [www.samtec.com/accelerateHP](http://www.samtec.com/accelerateHP).

**Conectores PICMG COM-HPC**

La nueva especificación PICMG COM-HPC ofrece flexibilidad del sistema y la conexión al adoptar un par de conectores de 400 patillas basado en las matrices de alto rendimiento AcceleRate HP de Samtec. Los conectores COM-HPC de Samtec unen las regletas de conexión a los módulos del servidor y el cliente. Son compatibles con interfaces existentes y futuras como PCIe5.0 y hasta 100 GbE. Los pares de conectores admiten una altura de apilamiento de 5 mm o 10 mm.

Para más información sobre los conectores COM-HPC de Samtec, descargue el folleto de soluciones de interconexión COM-HPC, visite [www.samtec.com/COMHPC](http://www.samtec.com/COMHPC) o envíe un correo electrónico a nuestros expertos técnicos en [COMHPC@samtec.com](mailto:COMHPC@samtec.com).

**Acerca de Samtec**Samtec, compañía fundada en 1976, es un fabricante de una amplia gama de soluciones interconexión electrónica con presencia global y una facturación de 800 millones de dólares. Entre sus productos se encuentran conexiones de alta velocidad entre placas, cables de alta velocidad, conexiones ópticas para placas intermedias y paneles, RF de precisión, apilamiento flexible, y componentes y cables micro/robustos. Con sus más de 40 sedes internacionales y sus productos comercializados en más de 125 países, la presencia global de Samtec le permite ofrecer un incomparable servicio al cliente. Para más información visite [http://www.samtec.com](http://www.samtec.com/).

**Samtec, Inc.**

**P.O. Box 1147**

**New Albany, IN 47151-1147**

**USA**

**Tel.: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)**

[**www.samtec.com**](http://www.samtec.com)

###

**Contacto:**

Matt Burns

[matthew.burns@samtec.com](mailto:matthew.burns@samtec.com)

812-944-6733